

AIチップ設計拠点フォーラム(第50回)開催案内【Web開催】

記

1. 日時 8月25日(金)13:30-16:40

2. 開催方法

Web フォーラム

(参加登録者には、8月23日~25日午前中に Web フォーラム参加のためのリンクアドレスを通知いたします)

3. アジェンダ

13:30-13:35 AI チップ設計拠点フォーラムについて (産総研・内山邦男)

13:35-14:35 半導体パッケージの3D化とシステム化
(産総研／高橋健司氏)

14:35-15:35 ケイデンスの先端プロセスへ向けた戦略と技術のご紹介
(日本ケイデンス・デザイン・システムズ社／牧井徹氏)

15:35-15:40 休憩

15:40-16:40 新次元への架け橋:チップレット技術による半導体革命
(Rapidus 株式会社／折井靖光氏)